

# MEMORIAL DESCRITIVO – DISCO DFL7161

## 1. INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

**Função:** Realizar corte à laser de Wafers de 300mm de diâmetro através do processo de ablação à laser para individualização de chips de memória.

**Modelo:** DFL7161

**Fabricante:** DISCO Corporation

## 2. FOTO DO EQUIPAMENTO



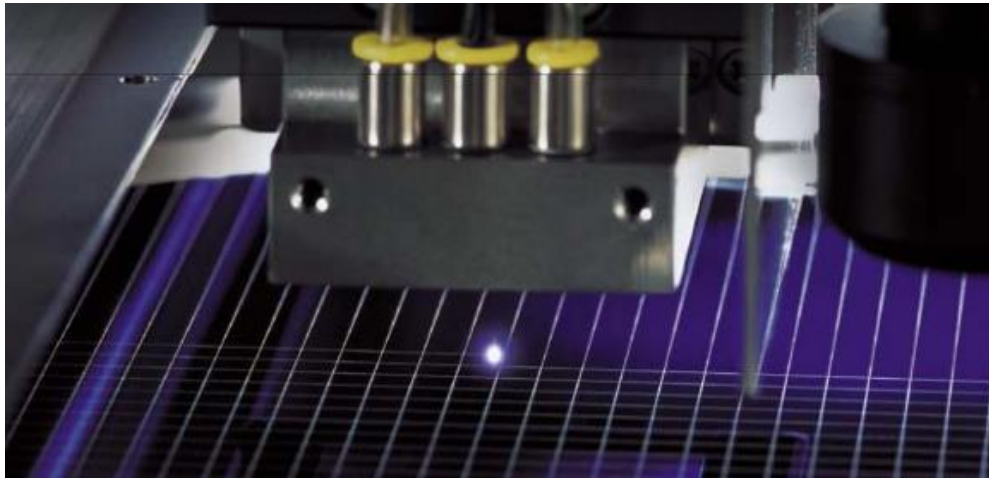
DFL7161

### 3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A DFL7161 é uma serra a laser totalmente automática para wafers de  $\Phi 300$  mm. Ela realiza uma série de processos, desde o revestimento COM HogoMax (Uma película protetora solúvel em água que impede que partículas de processamento a laser contaminem à superfície do wafer), corte e até a limpeza automática. As seções de revestimento e limpeza HogoMax estão localizadas separadamente para reduzir significativamente o tempo de espera.

Além disso, mantém alta qualidade de processamento por ser equipada com uma função de exibição do status do oscilador a laser e uma função de gerenciamento de energia do laser que se auto calibra, mantendo assim uma enorme precisão.

Este é um tipo de método de processamento a laser que ablaçiona objetos individuais, concentrando a energia do laser em uma área minúscula por um curto período de tempo.



*\*Imagem meramente ilustrativa*

Em conformidade com a IEC 60825-1: Segurança de Produtos a Laser Parte 1 e a CDRH: 21CFR1040 Normas de desempenho para produtos a laser, a máquina atende a todas as condições exigidas para produtos a laser e foi projetada com foco na segurança do usuário.

Para evitar qualquer perigo para os operadores, intertravamentos de hardware são instalados em locais inerentemente perigosos, impossibilitando a abertura do equipamento durante processamento.

Seguem abaixo as seções e sistemas embarcados no equipamento:

- Seção Carregamento de Cassete
- Sistema Alinhamento Automático
- Seção de Aplicação de Película Protetora
- Seção de Processamento à Laser
- Seção de Lavagem

#### 4. ESPECIFICAÇÕES

Especificação		Unidade	Dado
Método de processamento		-	Ablação
Tamanho de peça suportado		mm	Φ300
Eixo X (Mesa)	Faixa de processamento	mm	310
	Velocidade de movimento	mm/s	1 ~ 1000
Eixo Y (Mesa)	Faixa de processamento	mm	310
	Index	mm	0,0001
	Precisão de posicionamento	mm	0,003 / 310 (Erro único) 0,002/5
Eixo Z	Resolução do movimento	mm	0,000015
	Precisão da repetibilidade	mm	0,002
θ-axis (Mesa)	Ângulo de rotação máximo	Graus (°)	330
Dimensões do equipamento (L×P×A)		mm	1690 x 3452 x 1800
Peso do equipamento		kg	Apox. 6700